

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2015 年 9 月 11 日(11.09.2015)

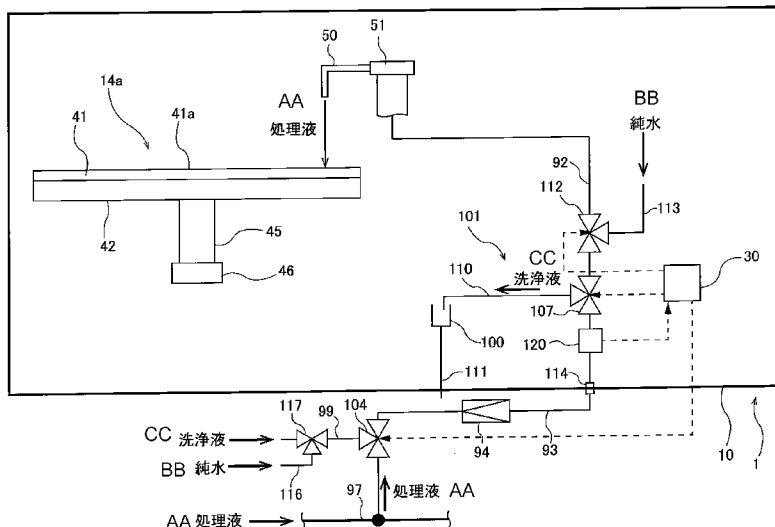


(10) 国際公開番号
WO 2015/133516 A1

- (51) 国際特許分類:
B24B 57/02 (2006.01) *B24B 49/08* (2006.01)
B24B 37/00 (2012.01) *H01L 21/304* (2006.01)
B24B 49/02 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2015/056341
- (22) 国際出願日: 2015 年 3 月 4 日(04.03.2015)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2014-045172 2014 年 3 月 7 日(07.03.2014) JP
- (71) 出願人: 株式会社 荏原製作所(EBARA CORPORATION) [JP/JP]; 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 山口 都章(YAMAGUCHI, Kuniaki); 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 株式会社 荏原製作所内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 渡邊 勇, 外(WATANABE, Isamu et al.); 〒1600023 東京都新宿区西新宿 7 丁目 5 番 8 号 GOWA 西新宿 4 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: SUBSTRATE PROCESSING SYSTEM AND SUBSTRATE PROCESSING METHOD

(54) 発明の名称: 基板処理システムおよび基板処理方法



AA Processing liquid
BB Pure water
CC Flushing liquid

(57) Abstract: The present invention relates to a substrate processing system and a substrate processing method that are capable of flushing the processing liquid supply line. The substrate processing system is provided with a substrate processing apparatus (1) for processing a substrate (W) and a flushing apparatus for flushing a distribution line (93) and a processing liquid supply line (92). The flushing apparatus is provided with: a flushing liquid supply line (99) that is connected to the distribution line (93); a drain mechanism (101) for guiding flushing liquid, which has been supplied to the processing liquid supply line (92) through the distribution line (93), to a liquid disposal point (100); a supply switching valve (104) for allowing either processing liquid or flushing liquid to flow inside the distribution line (93); and an action control unit (30) for controlling the actions of the drain mechanism (101) and the supply switching valve (104).

(57) 要約: 本発明は、処理液供給ラインを洗浄することができる基板処理システムおよび基板処理方法に関するものである。基板処理システムは、基

板Wを処理する基板処理装置(1)と、分配ライン(93)および処理液供給ライン(92)を洗浄するフラッシング装置とを備えている。フラッシング装置は、分配ライン(93)に接続された洗浄液供給ライン(99)と、分配ライン(93)を通じて処理液供給ライン(92)に供給された洗浄液を液体廃棄箇所(100)にまで導くドレイン機構(101)と、処理液または洗浄液のいずれか一方が分配ライン(93)内を流れることを許容する供給切り替え弁(104)と、ドレイン機構(101)および供給切り替え弁(104)の動作を制御する動作制御部(30)とを備える。